

# 电子元器件

# 行业分析

## 2019年9月：终端新品推动情绪，业绩期来临验证基本面

### 投资要点

- ◆ **行业指数显著强于市场整体，行业情绪强于基本面：**2019年9月国内A股市场的中信电子元器件行业一级指数上涨6.8%，位列第2位，涨幅方面强于沪深300、中小板和创业板指数，二级指数中各子行业均不同程度上涨。产业旺季，各大厂商新品密集发布，海外市场指数走势同样强于所在市场整体。
- ◆ **终端新品悉数亮相，摄像头和5G成为竞争点：**9月消费电子行业处于传统旺季，各大品牌厂商密集发布年度主要新品，苹果iPhone 11和华为Mate 30系列仍是关注重点，最大亮点在于摄像头创新，iPhone 11和Mate 30均增加了后置摄像头数量，另外苹果改善了充电，首次实现快充。安卓市场方面，各知名厂商持续发布5G新机，5G成为安卓市场的高端竞争点。非智能手机类产品方面，TWS耳机和手表继续渗透，VR/AR和智能电视在华为领导下成为行业新的关注点。
- ◆ **半导体国产化替代影响显现，代工和封测厂实质性受益：**行业数据显示行业下行过程仍然在延续，日韩贸易争端影响有限，存储器价格在7月显著上涨后，9月出现下滑，长期走势仍取决于行业供需情况。国产化替代有望在今年下半年产生确定性影响，目前来看，设计厂商忙于研发，业绩改善尚不明显，而代工和封测厂将实质性受益。
- ◆ **面板市场价格持续下跌，行业延续底部调整期：**显示屏市场的价格再次出现回落，尤其是大屏市场的价格持续下行，中小尺寸相对较为平稳，市场仍然显示出较为薄弱的供需关系，行业仍处于底部调整期。2020 OLED有望给市场供需带来新的变化。而在LED显示领域，应用场景拓宽，叠加70周年国庆庆典等事件性影响，需求端订单充足，供给端去产能接近尾声，行业有望迎来上涨机会。
- ◆ **投资建议：**对于四季度行业整体市场我们保持审慎态度，10月是季报披露的时间窗口，市场情绪持续高位推动的估值大涨后需要业绩的有效支撑，季报显得尤为重要。因此，我们延续“积极观望、谨慎参与”的建议，回避高估值和业绩明显不达预期的标的，维持行业评级“同步大市-A”。关注子行业首选仍然是消费电子板块，包括视频监控和元器件板块。个股核心推荐标的为立讯精密（002475）、长盈精密（300115）、莱宝高科（002106）、海康威视（002415）和江海股份（002484）。
- ◆ **风险提示：**需求旺季逐步来临的过程中实际需求增速不及预期；终端产品中在无线通信、传感器、人机交互等功能方面的创新无法达到消费者认可；贸易争端带来的终端需求变化以及产业链影响的不确定性；国产化自主可控的产业政策推出与落地实施不及预期风险。

 投资评级 **同步大市-A 维持**

首选股票		评级
002475	立讯精密	买入-A
300115	长盈精密	买入-B
002106	莱宝高科	增持-A
002415	海康威视	买入-A
002484	江海股份	买入-B

### 一年行业表现



资料来源：贝格数据

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	6.43	15.13	16.98
绝对收益	6.82	12.05	27.90

分析师

蔡景彦

SAC 执业证书编号：S0910516110001

caijingyan@huajinsec.cn

021-20377068

### 相关报告

电子元器件：终端新品持续发布，行业再次领涨 2019-09-22

电子元器件：苹果新品符合市场预期，国内市场涨势延续 2019-09-15

电子元器件：终端产品进入密集发布期，行业持续跑赢大市 2019-09-08

电子元器件：酒醒何时？橙黄橘绿？玉骨冰姿？陌上花？ 2019-09-04

电子元器件：2019年8月：夏去秋来，待到橙黄橘绿时？ 2019-09-02

## 内容目录

一、核心观点及投资建议	4
二、行业动态分析	5
(一) 产业数据跟踪	5
1、半导体行业数据汇总	5
2、消费电子行业数据汇总	8
3、面板行业数据汇总	9
(二) 行业新闻汇总	10
三、市场走势分析	19
(一) 国内 A 股市场走势分析	19
(二) 海外市场走势分析	20
1、香港	20
2、北美	21
3、台湾	22
四、投资建议及个股动态	23
1、立讯精密 (002475)	24
2、长盈精密 (300115)	24
3、莱宝高科 (002106)	25
4、海康威视 (002415)	25
5、江海股份 (002484)	26
五、风险提示	27

## 图表目录

图 1: 全球半导体销售收入(十亿美元)及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	5
图 2: 美洲半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	6
图 3: 欧洲半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	6
图 4: 亚太半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	6
图 5: 日本半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	6
图 6: 中国大陆半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	6
图 7: 亚太除中国半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)	6
图 8: 北美半导体设备出货额及增长率 (2018.08 ~ 2019.08)	7
图 9: 日本半导体设备出货额及增长率 (2018.08 ~ 2019.08)	7
图 10: DRAM 现货平均价 (2018.10 ~ 2019.09)	7
图 11: NAND Flash 现货平均价 (2018.10 ~ 2019.09)	7
图 12: 台积电月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	7
图 13: 日月光月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	7
图 14: 联发科月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	7
图 15: 中美晶月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	7
图 16: 全国手机出货量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	8
图 17: 国内品牌手机出货量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	8
图 18: 全国手机新机型上市量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	8
图 19: 国内品牌手机新机型上市量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	8
图 20: 鸿海月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	9

图 21: 大立光月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	9
图 22: TPK 月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	9
图 23: 群创光电月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)	9
图 24: 7 英寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 25: 14 寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 26: 32 英寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 27: 55 英寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)	9
图 28: 中信行业一级指数涨跌幅	19
图 29: 电子一级指数 v.s. 市场整体指数	19
图 30: 电子一级指数 v.s. 沪深 300 指数	19
图 31: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数	20
图 32: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数	20
图 33: 恒生资讯科技指数 v.s. 市场指数	21
图 34: 恒生资讯科技指数 v.s. 恒生指数	21
图 35: 费城半导体指数 v.s. 市场指数	21
图 36: 费城半导体指数 v.s. 标普 500 指数	21
图 37: 台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数	22
图 38: 台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数	22
图 39: 台湾资讯行业子版块指数	22
图 40: 台湾资讯行业子版块指数 v.s. 资讯行业指数	22
表 1: 电子元器件行业个股投资建议列表	4
表 2: 电子元器件行业个股涨跌幅榜	20
表 3: 香港资讯科技行业个股涨跌幅榜	21
表 4: 电子元器件行业个股投资建议列表	23

## 一、核心观点及投资建议

进入四季度，我们对于短期的预期保持审慎乐观，分子行业而言：

**消费终端市场：**9月份消费电子行业处于传统旺季，各大品牌厂商密集发布年度主要新品，苹果 iPhone 11 和华为 Mate 30 系列仍是关注重点，最大亮点在于摄像头创新，iPhone 11 和 Mate 30 均增加了后置摄像头数量，另外苹果改善了充电，首次实现快充。安卓市场方面，各知名厂商持续发布 5G 手机，5G 成为安卓市场的高端竞争点。非智能手机类产品方面，TWS 耳机和手表继续渗透，VR/AR 和智能电视在华为领导下成为行业新的关注点。

**半导体市场：**行业数据显示行业下行过程仍然在延续，日韩贸易争端影响有限，存储器价格在 7 月显著上涨后，9 月出现下滑，长期走势仍取决于行业供需情况。国产化替代有望在今年下半年产生确定性影响，目前来看，设计厂商忙于研发，业绩改善尚不明显，而代工和封测厂将实质性受益，本月华虹等代工厂积极布局新的产能。

**触控显示市场：**显示屏市场的价格再次出现了回落，尤其是大屏市场的价格持续下行，中小尺寸相对较为平稳，市场仍然显示出较为薄弱的供需关系，行业仍处于底部调整期。总体供需关系和产品发展的趋势看，2020 将会迎来 OLED 实质性的快速成长机会，市场供需才会有新的变化。而在 LED 显示领域，应用场景拓宽，叠加 70 周年国庆庆典等事件性影响，下游需求端订单充足，上游供给端去产能接近尾声，行业有望迎来上涨机会。

对于 2019 年四季度行业整体市场保持审慎态度，我们仍然认为存在较大不确定性。短期来看 10 月份是三季报披露的时间窗口，各大终端厂商本年度主要新品已基本亮相，旺季下市场情绪持续高位推动的估值大涨后需要行业基本面的有效支持，因此三季报显得尤为重要。10 月策略方面我们仍然延续 9 月“积极观望、谨慎参与”的建议，短期内看到的智能终端供应链上行空间有限，建议回避高估值和业绩明显不达预期的标的，维持行业评级“同步大市-A”的整体评级。

关注子行业首选仍然是消费电子板块和元器件板块，视频监控则是对贸易战放缓以及国内宏观经济有所改善预期的关注板块。个股核心推荐标的为立讯精密(002475)、长盈精密(300115)、莱宝高科(002106)、海康威视(002415)和江海股份(002484)。

表 1：电子元器件行业个股投资建议列表

代码	名称	市值(亿元)	PE(2018)	PE(2019E)	PE(2020E)	PB
002475.SZ	立讯精密	1,431	53	41	30	8.64
300115.SZ	长盈精密	129	335	28	22	2.98
002106.SZ	莱宝高科	58	26	22	20	1.51
002415.SZ	海康威视	3,018	27	22	18	8.27
002484.SZ	江海股份	54	25	20	18	1.65

资料来源：Wind，华金证券研究所（截止 2019 年 9 月 30 日收盘）

另外，我们建议持续关注标的包括科森科技(603626)、三环集团(300408)、深天马 A(000050)、三利谱(002876)、联创电子(002036)、欧菲光(002456)、环旭电子(601231)、全志科技(300458)、东软载波(300183)、汇顶科技(603160)、通富微电(002156)、太极实业(600667)、富瀚微(300613)、法拉电子(600563)等。

## 二、行业动态分析

从行业市场的数据看，半导体行业需求端和供给端的数据均显示行业仍处于去库存的过程中，月度收入连续下降符合预期，北美设备制造商出货金额连续 10 个月同比下降，但供给端跌幅持续收窄值得关注，存储器产品 DRAM 和 NAND Flash 的价格在 9 月出现下滑，日韩贸易争端影响有限，行业整体仍处于去库存阶段。终端市场方面，产业进入旺季，产品出货量同比降幅缩小，与之匹配的台湾产业链厂商出现不同程度的同比增长。面板市场的供过于求局面在短期终端需求不旺盛的情况下持续下跌，行业仍处于下行阶段，我们建议继续观察。

### （一）产业数据跟踪

半导体产业数据方面，2019 年 7 月份需求端销售收入同比下跌 15.5%，连续 7 个月出现同比下降的状况，供给端方面，2019 年 8 月半导体设备厂商的出货金额北美下降 10.5%，连续 10 个月下降，而日本同比下降 11.5%，连续 7 个月下降，值得注意的是供给端降幅持续收窄。存储器价格方面，DRAM 价格维持稳定，NAND Flash 现货价格受日韩争端影响在 7 月出现显著上涨后，9 月开始下滑，行业整体仍处于去库存阶段。

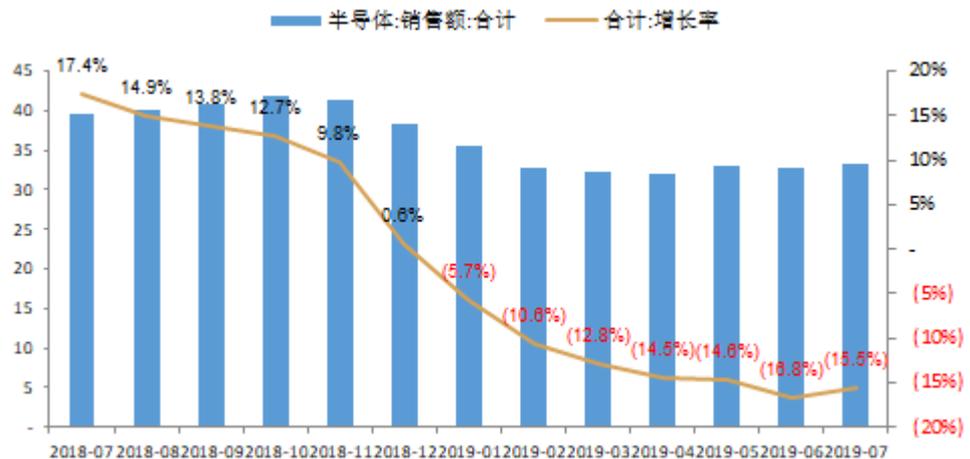
消费电子方面，工信部公布的全国手机出货量进一步下降。2019 年 8 月，全国手机出货量和国产品牌出货量分别同比下滑 5.3% 和 4.3%，新品上市数量分别同比下降 18.2% 和 23.1%，出货量和新机数量下降幅度均环比收窄。

面板行业整体的数据显示价格进一步下降，其中，中小尺寸市场价格基本持平，中大尺寸市场价格环比下跌，行业仍持续下行。

### 1、半导体行业数据汇总

2019 年 7 月，全球半导体销售收入 333.7 亿美元，同比下降 15.5%，自 1 月出现同比下滑以来已连续 7 个月下滑，下滑幅度相比 6 月有小幅收窄，我们认为短期半导体行业下行预期持续。

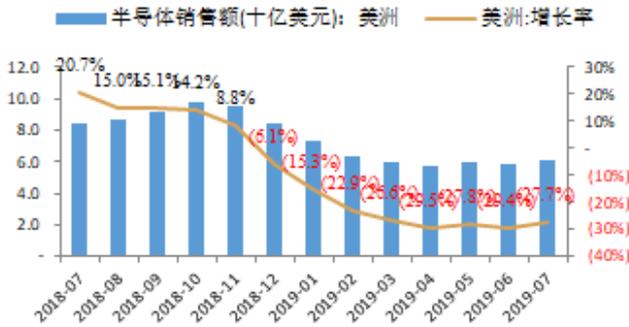
图 1：全球半导体销售收入(十亿美元)及增速（2018.07 ~ 2019.07）



资料来源：Wind、SIA、华金证券研究所

从地区市场分布看，全球市场美洲、欧洲、亚太和日本 4 个主要区域在 2019 年 7 月均同比持续下降，分别下降 27.7%、8.9%、12.7%和 12.1%，各地区下降幅度相比 6 月均有所收窄。

图 2: 美洲半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 3: 欧洲半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 4: 亚太半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 5: 日本半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

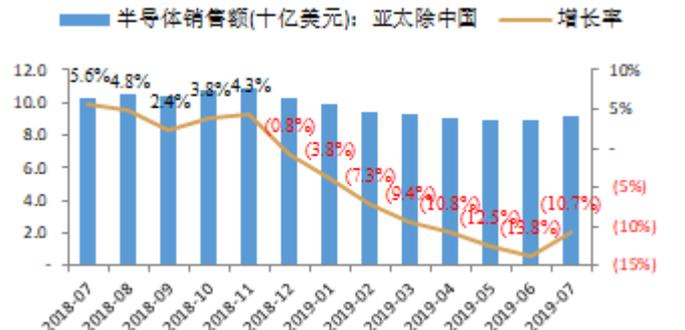
进一步细分亚太市场的数据我们看到，中国大陆地区市场的收入增速下滑 14.3%，而不包含中国大陆地区后收入增速下滑 10.7%，中国大陆地区的下滑幅度大于亚太其他地区。

图 6: 中国大陆半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

图 7: 亚太除中国半导体销售收入及增速 (2018.07 ~ 2019.07)



资料来源: Wind、SIA、华金证券研究所

供给端的数据看，Semi 公布的 2019 年 8 月出货额数据为 20.0 亿美元，同比下降 10.5%。SEAJ 公布的 2019 年 8 月动态平均出货额为 1,605.1 亿日元，同比下降 11.5%。可以看到的是，北美的出货额已经连续 10 个月出现了下行，日本则也是连续 7 个月出现了同比负增长，结合需求端数据看，我们认为行业下行的过程仍然在持续，但出货端的下降幅度持续收窄值得关注。

图 8: 北美半导体设备出货额及增长率 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, Semi, 华金证券研究所

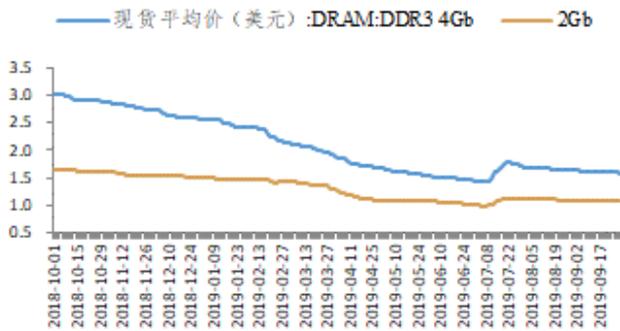
图 9: 日本半导体设备出货额及增长率 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, Semi, 华金证券研究所

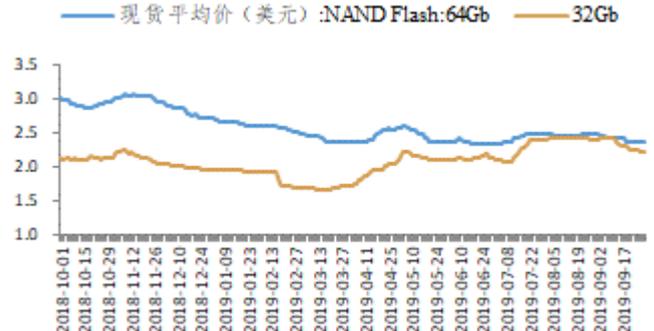
存储器市场看, DRAM 价格在 9 月保持相对稳定, NAND Flash 价格受日韩争端影响在 7 月显著上涨后, 9 月开始下滑, 行业整体仍处于去库存阶段。

图 10: DRAM 现货平均价 (2018.10 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, Semi, 华金证券研究所

图 11: NAND Flash 现货平均价 (2018.10 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, Semi, 华金证券研究所

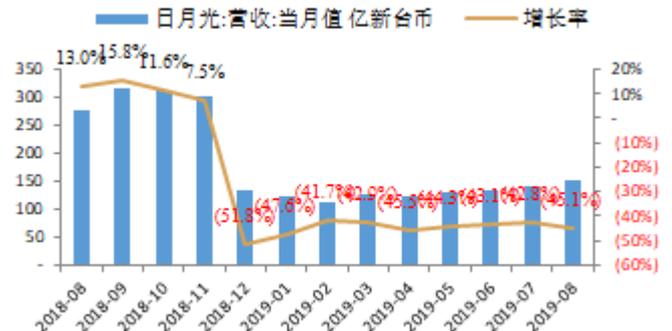
从台湾厂商公布的月度营收数据看, 半导体市场走势较为疲软, 除高端制造端代工业绩持续增长, 封测厂面临较大挑战, 设计厂商业绩再次出现下滑。

图 12: 台积电月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 13: 日月光月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

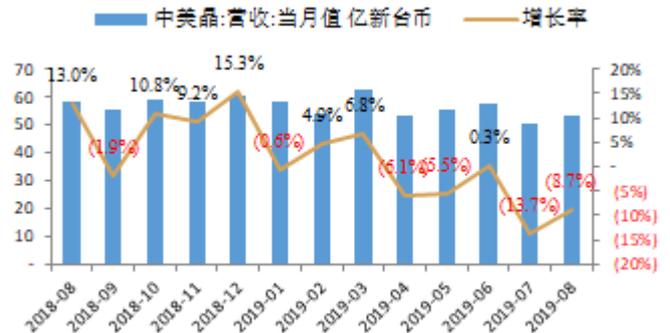
台湾半导体企业经营数据方面, 2019 年 8 月台积电营收同比增长 16.5%, 业绩已连续 3 个月增长, 日月光的营收同比下降 45.1%, 已连续 9 个月出现较大幅度下滑。

图 14: 联发科月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)

图 15: 中美晶月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所



资料来源: Wind, 华金证券研究所

设计厂商方面, 联发科 2019 年 8 月营收同比下降 2.0%, 自上个月业绩出现同比增长后再次出现下滑, 上游晶圆厂商中美晶的营收 7 月同比下降 8.7%。

## 2、消费电子行业数据汇总

2019 年 8 月, 工信部公布全国手机出货量为 3,087.5 万台, 同比下降 5.3%, 国内品牌手机的出货量为 2,895.7 万台, 占比达到 93.8%, 同比下降 4.3%。

图 16: 全国手机出货量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 17: 国内品牌手机出货量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

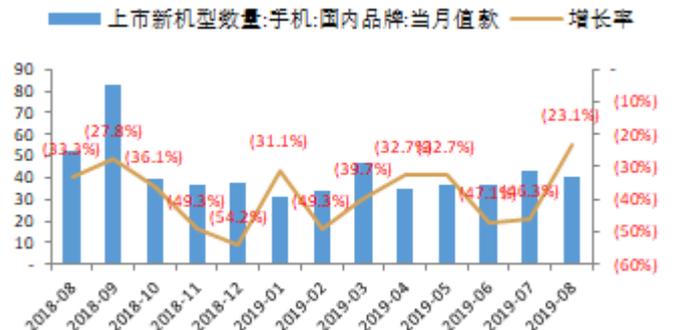
2019 年 8 月, 全国手机新机型上市数量为 45 款, 同比下降 18.2%, 国内品牌手机的新机型上市数量为 40 款, 同比下降 23.1%。

图 18: 全国手机新机型上市量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 19: 国内品牌手机新机型上市量及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

台湾相关产业链的月度营收数据看, 8 月除面板制造厂商出现了同比下滑, 其他组件供应商均出现了不同程度的同比增长。

图 20: 鸿海月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

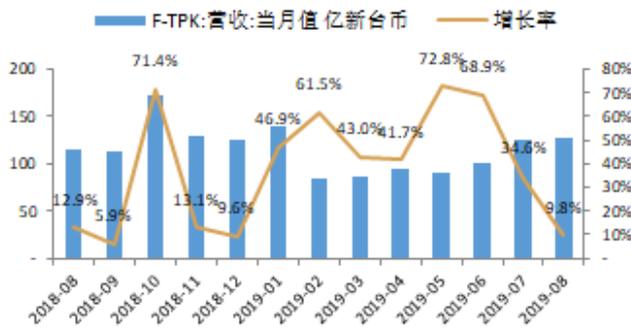
图 21: 大立光月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

鸿海精密 2019 年 8 月营收同比增长 0.5%，大立光 8 月营收同比增长 17.6%。

图 22: TPK 月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 23: 群创光电月度营收及增速 (2018.08 ~ 2019.08)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

TPK 在 2019 年 8 月营业收入同比上升 9.8%，群创光电营收同比下降 13.7%。

### 3、面板行业数据汇总

2019 年 9 月，不同尺寸的面板市场价格走势不同，中小尺寸面板价格维持稳定，而中大尺寸面板价格持续下降。

图 24: 7 英寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 25: 14 寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所

2019 年 9 月，中小尺寸市场 7 英寸产品价格环比下降 0.6%，14 英寸产品价格与上月持平。

图 26: 32 英寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)

图 27: 55 英寸面板价格及环比增速 (2018.09 ~ 2019.09)



资料来源: Wind, 华金证券研究所



资料来源: Wind, 华金证券研究所

中大尺寸市场，32寸和55寸的价格分别环比下降3.0%和3.8%。

## (二) 行业新闻汇总

**中国电信官方发布5G套餐预约 目前已有超过69万用户成功预约 (来源: TechWeb):** 9月30日，中国电信官方宣布，即日起可以预约中国电信5G套餐。中国电信官网首页显示，中国电信开启5G套餐预约，显示目前已有超过69万用户成功预约。除了中国电信之外，中国联通也在今天上午开启了5G套餐的预约。但是5G套餐的具体资费情况，目前三大运营商全都没有提及。

**华为证实：已生产不含美国零部件5G基站 (来源: 今日芯闻):** 据参考消息报道，华为创始人任正非9月26日在一个商务论坛上表示，脱离美国零部件的华为，还是可以生存的，并已在生产不包含美国部件的5G基站，明年将扩大产量。华为战略部总裁张文林对路透社说，华为为不含美国零部件的基站，其表现并不比用美国零部件的差。

**AMD 推出千元级处理器 R5 3500X: 6核6线程, 32MB三级缓存 (来源: c114):** 近日，AMD正式推出了一款千元级处理器AMD锐龙5 3500X，6核6线程，采用最新的Zen2架构，7nm工艺，售价1099元。据介绍，AMD R5 3500X为6核6线程，主频3.6GHz，最高加速频率4.1GHz，32MB三级缓存，TDP 65W，支持双通道DDR4-3200内存，采用了钎焊散热。

**格兰仕推出两款物联网家电芯片 (来源: TechWeb):** 广东格兰仕集团28日在顺德举行“超越制造”大会，发布两款名为BF-细滘、NB-狮山的AIoT家电芯片。目前，芯片BF-细滘已经开始应用。格兰仕集团副董事长梁惠强表示，格兰仕与RISC-V芯片企业SiFive China合作，未来就物联网家电产品设计一整套专用、可定制、可灵活设计、高性能、低成本的IoT芯片。另外，格兰仕还宣布打造了为RISC-V设计的开源操作系统GalanzOS。

**美国国际贸易委员会对半导体产品发起两起337调查 (来源: SEMIChina):** 据中华人民共和国商务部网站消息，2019年9月26日，美国国际贸易委员会(ITC)决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查。该调查由美国Globalfoundries公司于8月26日，依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出，指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。中国TCL集团、海信集团、联想集团和深圳万普拉斯科技有限公司等企业涉案。

**美光2019财年第四财季净利润同比下降87% (来源: 今日芯闻):** 美光9月27日公布了2019财年第四财季及全年财报。报告显示，美光科技第四财季营收为48.70亿美元，相比之下去年同期为84.40亿美元，上一财季为47.88亿美元；净利润为5.61亿美元，与去年同期的43.25亿美元相比下降87%，而上一财季为8.40亿美元。

**紫光芯云产业城项目一期开工 总投资约621亿元 (来源: SEMIChina):** 9月25日上午，东莞市推进粤港澳大湾区建设第三批重大项目集中开工活动暨滨海湾新区紫光、欧菲、正中重大项目动工仪式在东莞滨海湾新区隆重举行。落户滨海湾新区的紫光芯云产业城项目一期、正中创新综

合体、欧菲光电影像产业项目等三个项目均为省重点项目，总投资额达到 758 亿元，占全市本季度动工的重大项目总投资额的 68%。紫光芯云产业城项目规划用地约 1000 亩，投资约 621 亿元。

**Intel 推出新一代 QLC 固态硬盘 665p: 96 层堆叠 速度提升 50% (来源: SEMIChina):** 在韩国首尔举办的存储开放日活动中, Intel 首次推出了新款消费级 QLC 闪存 SSD, 665p。虽然主控延续 660p 的慧荣 SM2263 四通道, 但闪存颗粒升级为 96 层 3D QLC, 只是单 Die 依旧维持 1024Gb 容量(128GB)。

**1499 元起! realme X2 今日正式发售: 骁龙 730G+30W VOOC 4.0 快充 (来源: TechWeb):** 9月24日上午, realme 正式推出了继今年上半年推出的 realme X 之后的又一力作——realme X2, 该机搭载高通骁龙 730G 移动平台, 后置 6400 万四摄, 前置 3200 万像素摄像头。现在有最新消息, realme 官方近日宣布, realme X2 已于今日 0 点正式发售, 售价 1499 元起。

**徕卡电影四摄 华为 Mate30 系列国内发布 售价 3999 元起 (来源: 旭日大数据):** 9月26日, 2019 华为年度旗舰新品发布盛典在上海东方体育中心举行。华为面向国内市场, 正式发布新一代高端旗舰级手机华为 Mate30 系列, 推出华为 Mate30、华为 Mate30 Pro、华为 Mate30 RS 保时捷设计等产品。华为 Mate30 系列于 9 月 26 日 18: 08 正式开售, 国内售价 3999 元起。

**联电完成并购富士通半导体 (来源: SEMIChina):** 联华电子 9 月 25 日宣布, 公司已符合所有相关政府机构的成交条件而获得最终批准, 购买与富士通半导体(FSL) 所合资的 12 吋晶圆厂三重富士通半导体股份有限公司 (MIFS) 全部的股权, 完成并购的日期定于 2019 年 10 月 1 日, 至此联电 12 吋厂生产基地在亚太市场进一步多元化。

**三星破纪录首推 0.7 μm 图像传感器 (来源: 今日芯闻):** 据安卓中国报道, 9 月 24 日三星电子公布了其最新的手机图像传感器——ISOCELL Slim GH1, 是一款 4370 万像素传感器。虽然市面上已经有了许多 4800 万像素的手机, 但这是业界首款单像素感光元件尺寸缩小到 0.7 μm 的 CMOS。市面上目前常见的 4800W/6400W 传感器最小像素尺寸均为 0.8 μm。

**维信诺已进入华为供应链体系 明年开始正式批量供货 (来源: 今日芯闻):** 据 21 世纪经济 9 月 25 日报道, 小米集团的 5G 旗舰手机小米 9 Pro5G、小米 MIX Alpha5G 环绕屏概念手机粉墨登场, 作为供应商的维信诺再度受到关注。除了是小米最新 5G 旗舰手机的屏幕供应商, 维信诺已经悄然跻身华为供应商名录。“维信诺已经进入华为供应链体系, 基础测试已经通过了, 预计 10 月中旬进行小批量测试供货, 明年开始正式批量供货。”9 月 25 日, 业内相关人士透露信息给 21 世纪经济报道记者。

**传 LGD 考虑关闭生产 Apple Watch 面板的 OLED 工厂 (来源: SEMIChina):** 外电报导, 南韩 LG Display(LGD) 正在考虑关闭位于京畿道坡州的 E2 OLED 显示器工厂, 以应对不断扩大的损失。E2 是该公司第一家生产中小型设备萤幕的工厂, 并于 2013 年开始运营。近年来, 它已被其他更高效的 OLED 工厂所取代。若将此厂关闭后, LGD 可能将生产转移到其他工厂, 例如目前正在为智慧型手机和汽车生产 OLED 萤幕的 E5 工厂。

**平头哥发布自研 AI 芯片“含光 800” (来源: 今日芯闻):** 据 TechWeb 报道, 在 9 月 25 日的杭州云栖大会上, 达摩院院长张建锋现场展示了 AI 芯片——含光 800, 这也是阿里巴巴第一颗自研芯片。在业界标准的 ResNet-50 测试中, 含光 800 推理性能达到 78563IPS, 比目前业界最好的 AI 芯片性能高 4 倍; 能效比 500IPS/W, 是第二名的 3.3 倍。在杭州城市大脑的业务测试中, 1 颗含光 800 的算力相当于 10 颗 GPU。

**直追 7nm 水平 格芯推出 12LP+ 工艺: 性能提升 20% (来源: TechWeb):** 在今天开始的全球技术大会 GTC 上, Globalfoundries (格芯, 简称 GF) 宣布推出 12LP+ 工艺, 这是 12nm LP 工艺的改进版, 性能提升 20%, 功耗降低 40%。该工艺的一大特点是高速, SARM 单元电压低至 0.5V, 支持处理器、内存之间的高速低功耗数据传输, 这是计算及 AI 应用中的重要要求。

**长川科技收购 STI 交易完成 (来源: 今日芯闻):** 据东方财富网报道, 9 月 23 日, 长川科技发布公告, 公司完成了以对价 4.90 亿元发行股份购买长新投资 90% 股份的交易事项。交易标的长新科技的核心资产为新加坡集成电路封装检测设备制造公司 STI, STI 主要从事组装、测试和抛光

领域的解决方案和技术。

**vivo U3x 亮相：5000mAh+18W 闪充 799 元起（来源：快科技）：**9月25日消息，vivo U3x 正式亮相。售价方面，3GB+32GB 版售价 799 元，3GB+64GB 版售价 899 元，4GB+64GB 版售价 999 元，提供深湖蓝、子夜黑、赤茶红三种配色，9月29日正式发售。核心配置上，vivo U3x 采用 6.35 英寸水滴屏，分辨率为 1544×720，搭载高通骁龙 665 处理器，前置 800 万像素，后置 1300 万主摄+800 万超广角+200 万景深三摄，电池容量为 5000mAh。更重要的是，vivo U3x 标配 18W 双引擎闪充，支持反向充电，可为蓝牙耳机、手环等数码设备供电。

**小米 5G 手机国内首亮相 小米 MIX Alpha 手机引领全面屏再度革新（来源：TechWeb）：**9月24日，小米集团召开新品发布会，正式在国内首发两款 5G 手机。本次推出的小米 9 Pro 轻薄手机，标配 5G，支持双卡全网通、三频全覆盖。该手机搭载高通超旗舰处理器骁龙 855Plus，配备三重快充及索尼 4800 万 AI 超清三摄，售价 3699 元起，9月27日 10 点全渠道开卖。同时发布的小米 MIX Alpha 5G 概念手机，首创环绕屏，整机屏占比 180.6%。小米 MIX Alpha 首次搭载一亿像素摄像头，在工艺和材质方面，集合黑色精密陶瓷、钛合金材质及一整块蓝宝石玻璃超高端工艺材质于一体。小米 MIX Alpha 5G 环绕屏概念手机售价 19999 元，正在尝试小规模量产，预计 12 月底上市。

**总投资 450.6 亿元，钻石存储光刻机等项目落地青岛（来源：集微网）：**9月22日，在第五届中国人工智能大会上，投资总额 450.6 亿元的 24 个项目举行集中签约仪式，涵盖了人工智能、新一代信息技术、智能制造、芯片研发与应用、大数据技术与应用等。具体来看，包括投资 150 亿元的华润中科人工智能产业基金项目、投资 104.7 亿元苏州谷溪 CIS 感光芯片先进封装模组制造项目、投资 21 亿元的西安电子科技大学旭彤智能感知及物联网产业园项目、投资 17 亿元的钻石存储光刻机项目等。

**Marvell 完成对 Aquantia 的收购（来源：集微网）：**9月23日，Marvell 宣布已完成对 Aquantia 公司的收购。收购完成后，Marvell 的网络平台将由行业领先的 PHY、交换机和处理器形成强劲组合，可助力客户的系统实现每秒 MB 到每秒 TB 的飞跃。据悉，Marvell 收购 Aquantia 意在汽车网络市场，收购 Aquantia 可以补充 Marvell 的铜缆和光纤物理层产品，并进一步扩大 Marvell 在千兆 2.5G/5G/10G 以太网市场中的影响力。

**科锐将在美国纽约州建造全球最大 SiC 制造工厂（来源：今日芯闻）：**CREE 科锐官方微信报道，科锐 9月23日宣布计划在美国东海岸创建 SiC 走廊，建造全球最大的 SiC 制造工厂。科锐将在美国纽约州 Marcy 建造一座全新的采用最先进技术并满足车规级标准的 200mm 功率和射频 (RF) 晶圆制造工厂，而与之相辅相成的超级材料工厂的建造扩产正在公司达勒姆总部开展进行。

**台积电拟扩大 5 纳米芯片产能（来源：今日芯闻）：**据经济日报 9月23日报道，由于苹果、海思、超威、比特大陆和赛灵思五大客户都决定采用 5 纳米作为下一代主力芯片制程，台积电 5 纳米需求超预期。台积电已大幅上调产能布局，由原定每月 5.1 万片大增至 7 万片，同时加速量产脚步，提前明年 3 月量产。

**国内最大规模大硅片生产厂在杭州投产（来源：今日芯闻）：**据浙江在线 9月21日报道，国内规模最大、技术最成熟，拥有自主核心技术，并真正可量产半导体大硅片的生产厂——杭州中欣晶圆半导体股份有限公司大硅片项目在杭州钱塘新区竣工投产，实现了 8 英寸大硅片的正式量产，同时 12 英寸大硅片生产线进入调试、试生产阶段。

**vivo:年底将首发与三星合作的 5G 芯片（来源：今日芯闻）：**据凤凰科技 9月23日报道，vivo 执行副总裁胡柏山接受采访表示，vivo 从一年多以前开始规划深入到手机 SoC 的定义当中，今年年底会有产品首发搭载与三星共同合作的芯片。此前曾有报道称 vivo 挖人挖到上海紫光展锐家门口，此举被解读成 vivo 将进行自研芯片的布局。“纯粹是个乌龙。”胡柏山在采访中对此进行了否认，表示那段时间刚好招一些硬件工程师，短信发错了。

**西数出售 IntelliFlash 业务给 DDN 公司（来源：SEMICHINA）：**WDC 西数公司近日宣布退出存储系统市场，将旗下的 IntelliFlash 业务出售给了 DataDirect Networks（简称 DDN）公司。此外另一部分存储系统业务 ActiveScale 也将寻求出售。

**成都格芯 12 寸厂出售 (来源: 中国半导体论坛):** 9 月 23 日, 据知情人透露, 以色列晶圆代工企业 TowerJazz 将收购成都格芯工厂, Global Foundry 退出与成都政府的合作。一位 TowerJazz 的国内客户透露, TowerJazz 将在成都扩产 12 英寸 RF SOI 工艺, 他们之前的 RF SOI 产能一直很紧张。

**长鑫存储宣布其设计产能 12 万片生产线投产 (来源: SEMIChina):** 新华社消息, 在合肥召开的 2019 世界制造业大会上, 总投资约 1500 亿元的长鑫存储内存芯片制造项目宣布投产, 其与国际主流 DRAM 产品同步的 10 纳米级第一代 8Gb DDR4 首度亮相, 一期设计产能每月 12 万片晶圆。

**粤芯 12 英寸晶圆项目正式投产 (来源: 今日芯闻):** 据新浪科技报道, 9 月 20 日, 粤芯 12 英寸晶圆项目投产启动活动在广州举行。项目在达产后, 可实现月产 4 万片 12 英寸晶圆的生产能力。在项目定位上, 粤芯半导体以虚拟 IDM 的策略与重点芯片设计客户合作研发制程工艺、无缝连接设计、制造到应用。

**IDC: 第二季度中国可穿戴设备市场出货量同比增 34.3% (来源: SEMIChina):** 9 月 19 日消息, IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告, 2019 年第二季度》显示, 2019 年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为 2307 万台, 同比增长 34.3%。基础可穿戴设备 (不支持第三方应用的可穿戴设备) 出货量为 1846 万台, 同比增长 31.9%, 智能可穿戴设备出货量为 461 万台, 同比增长 45.0%。

**紫光控股 9.9 亿港元出售 67.82% 股份 (来源: SEMIChina):** 紫光控股于 17 日公告, 公司接到控股股东紫光科技战略投资有限公司通知, 其于当日与芯鼎及北京紫光资本订立股份购买协议, 芯鼎 (其与中青芯鑫简称“联合要约人”) 同意以对价 9.9 亿港元 (相对于每股约 1 元港币), 有条件地向其收购股份。本次交易完成后, 联合要约人及其一致行动人 (包括上海半导体装备材料基金及河南战兴基金) 将持有 9.87 亿股及权益, 约占公司总股本的 67.82%。

**花费 13 亿! 台积电订购新设备 (来源: 中国半导体论坛):** 9 月 19 日消息, 台湾地区半导体制造商台积电日前发布公告称, 向应用材料等公司订购价值新台币 56.68 亿元 (约合人民币 13 亿元) 设备。据了解, 此次台积电订购对象分别为 Lam Research International Sarl, Applied Materials South East Asia Pte. Ltd., IMS Nanofabrication AG 和 ASML, 但并未透露具体设备型号。

**Qorvo 推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块 (来源: SEMIChina):** 9 月 18 日, 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo 宣布推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块 (FEM)。这款新 FEM 非常适合 Wi-Fi 6 用户端设备 (CPE), 它将提供 HD / 4K 视频所需的性能和物联网 (IoT) 所需的效率集合在一起。

**我国首片自主研发的 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板下线 (来源: 集微网):** 据新华社最新消息, 我国首片自主研发的 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板于 18 日在安徽蚌埠下线, 随后有望实现产品批量生产。此次下线的玻璃基板在产品批量生产后将为我国液晶显示面板产业提供关键原材料保障。

**华为发布新一代 OceanStor Dorado 智能全闪存 (来源: 今日芯闻):** 据观察者网 9 月 18 日报道, 在华为全联接大会 2019 期间, 华为发布了基于鲲鹏和昇腾处理器的新一代 OceanStor Dorado 智能全闪存。华为新一代 OceanStor Dorado (OceanStor C 系列) 智能全闪存基于鲲鹏 920、昇腾 AI 芯片 310 构建端到端极速平台, 实现业界领先的 2000 万 IOPS 以及 0.1ms 时延; 采用 SmartMatrix 全互联高可靠架构, 确保单系统最大可容忍 7 个控制器失效, 真正做到企业核心业务持续在线; 基于内嵌昇腾 AI 芯片的深度学习, 读缓存命中率提升 50%, 并基于云上 AI 联动实现全生命周期的智能运维。

**天津飞腾新一代桌面处理器 FT-2000/4 正式发布 (来源: 摩尔芯闻):** 9 月 19 日, 天津飞腾信息技术有限公司正式对外发布自主研发的新一代桌面处理器 FT-2000/4, 该产品性能达到新高。FT-2000/4 通用计算处理器芯片集成 4 个飞腾自主研发的处理器核心 FTC663, 兼容 64 位 ARMv8 指令集, 16nm 制程, 主频最高 3.0GHz, 最大功耗 10W。该款芯片在 CPU 核心技术上实现了新突破, 进一步缩小了与国际主流桌面 CPU 的性能差距, 并在内置安全性方面拥有独到

创新。

**台积电宣布将建全球首家 2nm 工厂 (来源: TechWeb):** 据外媒消息,台积电正式宣布启动 2nm 工艺的研发,这使其成为第一家宣布开始研发 2nm 工艺的公司。消息称,按照台积电的说法,2nm 工艺研发需时 4 年,最快也得要到 2024 年才能进入投产。这段时间里 5nm 工艺乃至 3nm 工艺均会成为过渡产品,以供客户生产芯片的需要。对于 3nm,台积电表示,在台湾的第一家 3nm 工厂将于 2021 年投产,将于 2022 年批量生产。

**高通 31 亿美元收购 TDK 在射频前端合资公司 RF360 的股份 (来源: SEMIChina):** 高通当地时间周一宣布,将斥资 31 亿美元收购 TDK 公司在射频前端(RFFE)技术合资企业 RF360 Holdings 中的剩余股权,这笔交易将让高通把 RFFE 技术完全整合到下一代 5G 解决方案中。高通将获得 RF360 Holdings 所有工程师和知识产权。拥有 RF360 Holdings,在开发将蜂窝调制解调器与天线连接起来的 RFFE 部件方面,高通的能力将提到加强。

**华为发布全球最快 AI 产品 集成 1024 颗芯片 (来源: 今日芯闻):** 据量子位 9 月 18 日报道,华为全连接大会开幕,推出又一重量级 AI 产品 Atlas900。Atlas900 训练 ResNet-50 只需 59.8 秒,在同等精度上,比排名第二快 15%。如此算力还可以广泛应用到科学研究与商业创新中,比如天文探索、气象预测、自动驾驶、石油勘探等领域。与此同时,华为也会以极优惠的价格向全球科研机构 and 大学开放。

**华虹无锡厂一期 12 英寸产线建成投产 (来源: SEMIChina):** 随着首批 12 英寸硅片进入工艺机台,开始 55 纳米芯片产品制造,华虹半导体(无锡)有限公司(华虹七厂)作为华虹集团在上海市域以外的第一个项目投入量产。目前在上海和无锡华虹共投产了 3 条 8 英寸、2 条 12 英寸生产线。华虹表示,还将适时在无锡建二期工厂和三期工厂,而届时制造工艺节点也将同步提升,三期全部建成后华虹在无锡将有 3 条 12 英寸生产线。

**无界瀑布屏惊艳亮相! 5G 水桶机 vivo NEX 3 正式发布 (来源: TechWeb):** 2019 年 9 月 16 日, vivo NEX 系列新机 NEX 3 5G 上海正式发布。硬件上, NEX 3 不仅搭载 5G 通信技术,更将一块 6.89 英寸柔性屏弯曲延至近乎垂直,打造出兼具未来科技感与灵动质感的无界瀑布屏。NEX3 标配高通骁龙 855 Plus 处理器,搭载 4500mAh 超大电池和 44W 超快闪充,采用 6400 万超高像素主摄+1300 万广角/微距+1300 万长焦三摄方案,以及升级的 Jovi 人工智能解决方案,全方位释放 NEX 3 5G 旗舰的澎湃势能。

**紫光集团将加速自主研发 DRAM (来源: 今日芯闻):** 据经济日报 9 月 17 日报道,紫光集团 DRAM 事业群 CEO 高启全表示,紫光集团未来投入 DRAM 领域,会走先前开发储存型闪存(NAND Flash)的自主研发模式。紫光集团内部计划将在未来十年内投资 8000 亿元人民币,以加快 DRAM 量产。

**比特大陆发布算丰第三代 AI 芯片 BM1684 (来源: 今日芯闻):** 9 月 17 日,比特大陆发布了算丰第三代 AI 芯片 BM1684,该芯片聚焦于云端及边缘应用的人工智能推理,采用台积电 12nm 工艺。Winograd 卷积加速下 INT8 算力可达 35.2TOPS,典型功耗仅 16W,为视频结构化和加解密算法均做了特别优化。据称是全球一款城市大脑专用芯片。

**新款苹果用 LCD 订单不如预期, JDI 白山工厂仍无限期停工 (来源: 集微网):** 苹果 LCD 供应商之一的 JDI 旗下白山工厂将无限期停工,主因 iPhone 11 用 LCD 订单量不如原先预期。据报道,因苹果预计 9 月 20 日开卖的新型 iPhone 用 LCD 订单量较原先预期来得少,光靠茂原工厂就可满足需求,也让 JDI 决定延长白山工厂的停工时间,而此次延长停工虽不会设定期限,但预估 JDI 会在 1 年后重新对白山工厂的存废进行研判。

**京东方: 重庆第六代柔性 AMOLED 生产线已开工建设 (来源: 集微网):** 9 月 16 日,京东方在互动平台表示,公司重庆第六代柔性 AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)生产线已开工建设,预计 2021 年投产。京东方还表示,公司成都第 6 代柔性 AMOLED 生产线目前爬坡进展顺利,一期已经满产,良率保持较高水平并持续提升中;绵阳第 6 代柔性 AMOLED 生产线刚刚量产,正在进行产能和良率爬坡。

**华为海思发布全球首款基于 AVS3 标准的 8K/120P 解码芯片 (来源: 今日芯闻):** 荷兰当地时间

9月13日，在IBC2019大会上，上海海思技术有限公司、AVS产业联盟、当虹科技、广东省超高清视频创新中心和鹏城实验室联合发布了首个基于AVS3标准的8K端到端解决方案，同时推出全球首款基于AVS3标准的支持8K分辨率、120fps的超高清芯片Hi3796CV300。

**华为有意向西方公司出售5G技术（来源：今日芯闻）：**近日，华为创始人兼CEO任正非提出了一个大胆的想法，有意向西方公司出售华为的5G技术，目的是制造一个能在5G上与华为竞争的对手。买家只要支付一次性费用，就能永久使用华为现有的5G专利、许可证、代码、技术蓝图和生产技术诀窍。在任正非看来，一家中国公司将为全球大部分5G网络提供设备，这种前景令许多西方人感到担忧，上述举措将有助于营造公平的竞争环境，而平衡利益分配有利于华为的生存。

**SEMI：2020年新晶圆厂投资增至500亿美元（来源：今日芯闻）：**据中时电子报9月16日报道，国际半导体产业协会SEMI预估，2020年全球晶圆厂建设投资总额将达500亿美元，较去年增加约120亿美元。全新建设的晶圆厂计划在未来新增产能将超过每月74万片，而新增产能集中在晶圆代工（37%）、存储器（24%）和MPU微处理器（17%）上。

**三星2021年量产3nm工艺芯片（来源：SEMICChina）：**三星近日在日本举行的“三星晶圆代工论坛”（SFF）上，公布了其新一代工艺的进展，3nm工艺预计2021年量产。据悉在3nm节点上，三星将从FinFET晶体管转向GAA环绕栅极晶体管工艺。GAA晶体管，三星称之为3GAE工艺。

**华为募资30亿元：用于公司运营资金（来源：旭日大数据）：**9月11日，交易商协会“非金融企业债务融资工具注册系统”显示，华为投资控股有限公司（下称华为）提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料，目前正处于“预评中”。根据募集说明书，华为此前仅在境外发过四单美元债券及两单点心债，并无境内发债经历。因此，这将是华为首次在境内债券市场筹资。根据募集说明书，第一期、第二期中期票据拟发行规模均为30亿，用途也均为补充公司本部及下属子公司营运资金。发债原因主要是“预计公司各项业务未来保持稳定增长态势，资金支持也将进一步增加”。

**苹果SiP助攻，日月光营收将创新高（来源：摩尔芯闻）：**苹果iPhone 11系列及Apple Watch 5等系统级封装（SiP）订单到位，封测大厂日月光投控营运大跃进，8月集团合并营收400.39亿元（新台币），创下投控成立以来单月营收历史新高。受惠于苹果SiP订单加持，加上华为海思、高通、联发科等大客户扩大下单，法人上修日月光投控第三季集团合并营收季成长率将上看三成，第四季可望续创新高。

**iPhone 11系列国行售价5499元起 13日开启预购（来源：TechWeb）：**9月10日凌晨，苹果一年一度新品发布会发布3款新iPhone：iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。iPhone 11核心处理器采用A13仿生芯片，苹果称其CPU、GPU均超过业界旗舰芯片。iPhone Pro系列后置三枚摄像头，分别为1200万像素长焦摄像头、1200万像素广角摄像头和1200万像素超广角摄像头。

**SK集团宣布收购杜邦碳化硅晶圆业务（来源：今日芯闻）：**据BusinessKorea报道，SK Siltron于9月10日宣布，董事会已批准以4.5亿美元收购美国杜邦的碳化硅晶圆业务的计划。SK Siltron从杜邦手中收购SiC晶圆业务，将有助于该公司扩大市场份额。此外，据市场调研公司IHS和Yole预测，基于SiC晶圆的电力和电信功率半导体全球市场价值预计将从2019年的13亿美元增长到2025年的52亿美元。

**英特尔新款26核心处理器曝光（来源：SEMICChina）：**根据Tom's Hardware的报道，英特尔可能正计划推出精简版的Xeon W-3175X处理器。Xeon W-3175X是英特尔一年前推出的28核HEDT旗舰产品，也是C621芯片组中唯一使用LGA 3647插槽的CPU。SiSoftware的数据显示，新款的至强采用了26核心，主频4.1GHz。目前，英特尔Xeon W-3175X售价为3,000美元，是英特尔最昂贵的高端桌面级CPU。因此新款的26核心至强应该会定位中高端，外媒预计售价会在2000美元左右。

**深圳欲2020年实现5G网络全覆盖（来源：今日芯闻）：**近日，深圳市举行了5G建设动员大会。

在本次大会上,深圳市定下了明确的 5G 建设目标:2019 年底争取实现重点区域 5G 全覆盖,2020 年实现全市 5G 全覆盖和独立组网。同时,深圳也将积极推动 5G 政务,在交通、警务、城市管理、电力、水务、健康医疗、教育、旅游等各大领域开展 5G 重点项目。根据规划,到 2022 年底,深圳需打造出 2 个超千亿元的 5G 产业集聚区。

**OPPO Reno2 发布:阳光护眼全景屏+视频超级防抖 2999 元(来源:TechWeb):** 9 月 10 日上午,OPPO Reno2 正式发布。售价方面,OPPO Reno2 售价 2999 元(8GB+128GB),提供薄雾粉、深海夜光、海洋之心三种配色,9 月 12 日正式发售。OPPO Reno 2 采用 6.5 英寸 20:9 阳光护眼全景屏。据悉,Reno2 是全球首款通过德国莱茵 TUV Full Care Display 认证的手机产品。

**Intel: 10nm 产能超过预期 2020 年同时推出两代服务器 CPU(来源:TechWeb):** 在花旗全球技术大会上,Intel 副总裁、云平台及技术部门总经理 Jason Grebe 回答了分析师提问,尤其是有关 Intel 10nm 工艺及服务器/数据中心处理器进展相关的内容。Jason Grebe 提到 10nm 工艺进展很不错,今年已经可以说是提前量产了,而且产能也是超过预期的。2020 年上半年将会推出代号 Cooper Lake 的 14nm 服务器版处理器,下半年就能推出 10nm 工艺的 Ice Lake 服务器版处理器。

**台积电 8 月营收 1062 亿新台币 环比大涨 25%(来源:TechWeb):** 台积电今天公布的 8 月份营收创造了记录,当月合并营收 1061.8 亿新台币(约合 242 亿人民币),环比增长 25.2%,同比也大涨了 16.5%。在 8 月份强劲营收的带动下,台积电 1 到 8 月份合并营收 6505.78 亿新台币,同比增长了 0.6%。台积电营收大涨的主要功臣是 7nm 工艺,主要客户包括苹果、AMD、华为、赛灵思、高通等,不过现在这一轮增长的主要动力还是华为、苹果,两家公司为 Q3 季度的麒麟 990、A13 处理器备货带动了 7nm 订单的增长。

**美国归还扣留 2 年华为货物!外交部:从事实上承认其行为违法性(来源:今日芯闻):** 9 月 10 日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。对于美国政府归还华为扣留两年的货物,华为撤回今年 6 月对美国多个政府部门的诉讼一事,华春莹表示,美国政府从事实上承认了其行为的违法性和随意性。

**IDC: 明年 5G 智能手机出货量将占总出货量 8.9% 达 1.235 亿部(来源:TechWeb):** 据国外媒体报道,当地时间周一,市场研究机构 IDC 发布了有关智能手机市场的最新预测报告。在报告中,IDC 预计,2020 年 5G 智能手机出货量将占智能手机总出货量的 8.9%,达到 1.235 亿部。到 2023 年,这一比例预计将增长至 28.1%。

**2019 年第二季度全球半导体设备销售额为 133 亿美元(来源:SEMIChina):** 美国加州时间 2019 年 9 月 10 日,SEMI 报告指出,2019 年第二季度全球半导体制造设备销售额为 133 亿美元,比 2018 年同期下降 20%,比上一季度下降 3%。

**OPPO 将首发全新骁龙 5G 集成芯片(来源:摩尔芯闻):** 9 月 6 日晚间,高通正式发布了旗下首个集成 5G 基带的手机芯片,发布会上高通表示,全新骁龙 5G 集成芯片采用 7nm 制程工艺。骁龙官宣后不久,OPPO 副总裁沈义人则转发微博表示,今年 OPPO 将会全球首发,并且转发了高通关于最新骁龙 5G 芯片的官宣微博。按照目前 OPPO 的新品发布动向来看,OPPO Reno 系列或者 K 系列产品将会是有望全球首发搭载最新 7nm 全新骁龙 5G 集成芯片。

**华为宣布 9 月 19 日发布华为智慧屏(来源:SEMIChina):** 9 月 8 日,华为宣布,华为智慧屏 9 月 19 日全球发布,并提前于 9 日 10:08 开放线上预约。今年 7 月底,余承东表示,华为智慧屏将搭载华为鸿蒙系统,会推出 55 英寸、65 英寸、75 英寸产品。同时华为的麒麟 AI 芯片、鸿鹄智慧显示芯片、凌霄 Wi-Fi 芯片,能让交互、音画、连接全面智慧化。

**华为布局第三代半导体材料 争夺 5G 时代主动权(来源:TechWeb):** 9 月 9 日,日前,华为公司通过旗下的哈勃科技投资有限公司投资了山东天岳公司,占股 10%,后者是一家以碳化硅为主的半导体材料公司,这意味着华为正在布局新一代半导体技术。

**小米发布全球首个 30W 超级无线快充 小米 9 Pro 5G 版将率先搭载(来源:TechWeb):** 9 月 9 日,小米发布全球首个 30W 超级无线快充,包含全球最快大功率反向无线充电在内的四大技术

创新，即将推出的小米 9 Pro 5G 版将搭载这一技术，同时更高效的 40W 无线快充也已处于测试阶段。

**传三星 A 系列将搭载联发科 P22 芯片 (来源: 今日芯闻):** 近日, 市场传出联发科将以 P22 手机芯片打入三星下半年即将推出的 A6、A7 及 A8 等系列机种, 预计第三季下旬将可望开始逐月放大出货量。由于三星 A 系列一向都是主流平价机种, 在全球都有不错的销售实力, 因此推估联发科本次出给三星的 P22 手机晶片将有会看 5,000 万套水准, 替下半年营运注入一股强心针。

**郑力离职 NXP, 赴长电科技担任 CEO (来源: 摩尔芯闻):** 此前, 援引芯谋研究首席分析顾文军先生消息, 恩智浦大中华区总裁郑力离职, 预计会加入中国半导体产业一重要平台。而据最新消息显示, 郑力先生会加入国内的封测巨头长电科技, 担任 CEO 一职。

**华为发布麒麟 990 系列芯片: 将在华为 Mate30 系列首发 (来源: TechWeb):** 9 月 6 日, 华为消费者业务 CEO 余承东在 2019 德国柏林消费电子展 (IFA) 上发表“Rethink Evolution”主题演讲, 面向全球推出华为最新一代旗舰芯片麒麟 990 系列, 包括麒麟 990 和麒麟 990 5G 两款芯片。其中, 麒麟 990 5G 是全球首款旗舰 5GSoC 芯片, 在性能与能效、AI 智慧算力及 ISP 拍摄能力等方面进行全方位升级。麒麟 990 系列芯片将在华为 Mate30 系列首发搭载。该款产品将于 9 月 19 日在德国慕尼黑全球发布。

**LG 电子推出双屏 5G 智能手机 将于今年第四季度上市 (来源: TechWeb):** 据国外媒体报道, 今日, LG 电子在柏林举行的国际电子消费品展览会 (IFA) 上推出了其最新 G 系列智能手机 LG G8X ThinQ, 这款手机可变为双屏幕, 且具有 5G 版本。LG G8X ThinQ 将于今年第四季度在主要市场上市。

**兆易创新 Q2 强势上升 全球 NOR Flash 市场排名涨至第四 (来源: 集微网):** 据 CINNO Research 对第二季度存储产业研究报告显示, 在 NOR Flash 领域长久以来位居第五位的兆易创新, 超越美光在史上首度站上第四名的位置, 创下中国存储产业的新里程碑。这是同属于兆易创新和国内存储产业的高光时刻。

**三星突然取消所有 Galaxy Fold 折叠屏预订 (来源: TechWeb):** 今天早些时候, 三星宣布正式重新推出 Galaxy Fold 折叠屏手机。三星表示该设备将于 9 月 6 日在韩国上市。即使三星 Galaxy Fold 已准备好重新启动, 但三星也取消了该设备的所有预订。三星提到, 他们取消了预订, 以“重新考虑整个客户体验”。对于所有取消的预订客户, 三星赠送了价值 250 美元的三星在线商店积分券。

**韩国三星、LGD 拟大裁员 (来源: 中国半导体论坛):** 9 月 6 日消息, 台厂华映才刚宣布将大量解雇 2100 名员工, 市场传出, 韩国两大面板厂三星 (SDC) 与乐金显示 (LGD) 在不敌中国 LCD 低价竞争下, 本月开始也将启动一波大规模人员缩编计划, 影响人数超过 3000 人。

**东芝存储器最新发布 XL-Flash 技术 (来源: SEMIChina):** 据外媒报道, 东芝存储器美国子公司宣布推出一种新的存储器 (Storage Class Memory) 解决方案: XL-Flash, 该技术是基于创新的 Bics Flash 3D NAND 技术和 SLC, XL-Flash 将为数据中心和企业存储带来了低延迟和高性能的解决方案, 样品预计将于下月送样检测, 或将于 2020 年量产。

**华为畅享 10 Plus 售 1499 元起 (来源: c114):** 华为今天下午在西安正式发布畅享系列新品手机华为畅享 10 Plus, 前置可升降摄像头、后置 4800 万超广角 AI 三摄、全视屏、麒麟 710F 芯片、全系标配 128GB 机身大内存、多种时尚配色, 售价 1499 元起。

**4800 万像素四摄+骁龙 712 realme Q 发布 998 元起售 (来源: TechWeb):** 2019 年 9 月 5 日, 新锐智能手机品牌 realme 举行线上“真敢说”脱口秀发布会, 正式发布了全新产品——realme Q。realme Q 凭借 998 元起步价、4800 万像素四摄、骁龙 712 AIE 处理器和出众的外观设计等一系列“敢越级”产品力, 让千元机市场再掀波澜。

**三星 Galaxy Fold 明日在韩国开售: 支持 5G 网络 售价近两千美元 (来源: TechWeb):** 9 月 5 日消息, 据国外媒体报道, 三星电子今日表示, 其首款折叠屏智能手机 Galaxy Fold 明天将在韩国上市发售, 支持 5G 网络。三星电子表示, Galaxy Fold 定价为 239.8 万韩元 (约合 1,977.47 美元)。三星还表示, 随后将在英国、法国、德国与美国等一些国家提供 5G 与 LTE 两种版本 Galaxy

Fold。三星未提供在这些国家的具体发售日期。

**中光电收购智动全球微机电业务，抢滩智能感测商机（来源：SEMICHina）：**液晶背光模块厂中光电宣布，已于7月底新设100%控股子公司中光电智能感测，并于9月初完成收购智动全球（Global MEMS）微机电系统（MEMS）相关业务及资产，将正式跨入MEMS新事业领域。

**华为鲲鹏、昇腾处理器将应用在我国电力行业（来源：今日芯闻）：**据新华社深圳9月4日报道，南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统，涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等，并自研应用迁移平台，实现该局IDC（信息数据中心）软硬件资源全栈（所有核心软件和硬件）国产化的成功测试。

**三星发布5G移动设备处理器Exynos980（来源：今日芯闻）：**9月4日，三星电子发布了支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980，实现将5G通信调制解调器与高性能移动AP合二为一。Exynos980是三星电子推出的首个5G集成SoC产品。该产品将两个性能完全不同的芯片合二为一，在降低功耗的同时，减少部件所占体积，从而方便移动设备的设计。

**荣耀20S手机正式发布：7nm麒麟810、年度最强自拍手机（来源：快科技）：**今晚在武汉发布会上，荣耀正式推出了荣耀20S手机，这是荣耀20系列第四款手机了，也是荣耀最强自拍手机，配备了7nm麒麟810处理器，6+128GB版售价1899元。

**全球十大晶圆代工厂最新营收排名：台积电第一三星第二（来源：TechWeb）：**今天，集邦咨询发布了全球前十大晶圆代工厂最新营收排名，前三名分别为台积电(TSMC) 50.5%、三星(Samsung) 18.5%与格芯(GlobalFoundries) 8%。之后分别是联电、中芯国际、高塔半导体、华虹半导体、世界先进、力晶和东部高科。

**国产氟化氢替代日本（来源：中国半导体论坛）：**据韩媒报道，SK海力士中国无锡工厂已经完全使用中国生产的氟化氢取代了日本产品。报道称，三星电子和SK海力士寻找日产氟化氢替代材料的工作比预期进展顺利，预计到年底前后，全球范围内工厂可以完全替代日本产品。

**三星Galaxy A90 5G正式发布，支持Sub 6GHz频段（来源：c114）：**今天三星在官网正式发布了Galaxy A90 5G手机，外挂骁龙X50基带，支持NSA下的Sub 6GHz频段，进一步降低5G手机的入门门槛。

**紫光展锐春藤8908A获欧洲最大电信运营商认证（来源：今日芯闻）：**紫光展锐9月3日宣布，春藤8908A成功获得了德国电信Deutsche Telekom在其窄带物联网（NB-IoT）解决方案IoT Solution Optimizer的全球认证。春藤8908A将成为德国电信在IoT Solution Optimizer全球范围的官方推荐芯片平台，而紫光展锐也将进入德国电信在全球IoT市场的供应商体系。

**华为实现超20万个5G基站发货（来源：今日芯闻）：**9月3日，华为亚太创新日在成都召开。徐文伟表示，华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同，发货20多万个5G基站，接近三分之二的5G基站是由华为建设的。据介绍，商用合同28个来自欧洲、11个来自中东、4个来自美洲、1个来自非洲，6个来自亚太。

**长江存储启动64层3D NAND闪存量产（来源：SEMICHina）：**长江存储9月2日宣布，公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256Gb TLC 3D NAND闪存，以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。作为中国首款64层3DNAND闪存，该产品将亮相IC China 2019紫光集团展台。

**东芝收购光宝科技SSD业务（来源：今日芯闻）：**据工商时报报道，中国台湾光宝科技8月30日宣布，其固态储存（SSD）转让给东芝。本交易对价暂定为现金1.65亿美元，预计将于2020年上半年完成，并将根据惯例进行收市调整和监管审批。光宝集团表示，此举为了丰富半导体产业上下游资源，可以快速提升营运规模，并且最终与东芝在固态存储事业达到双赢。

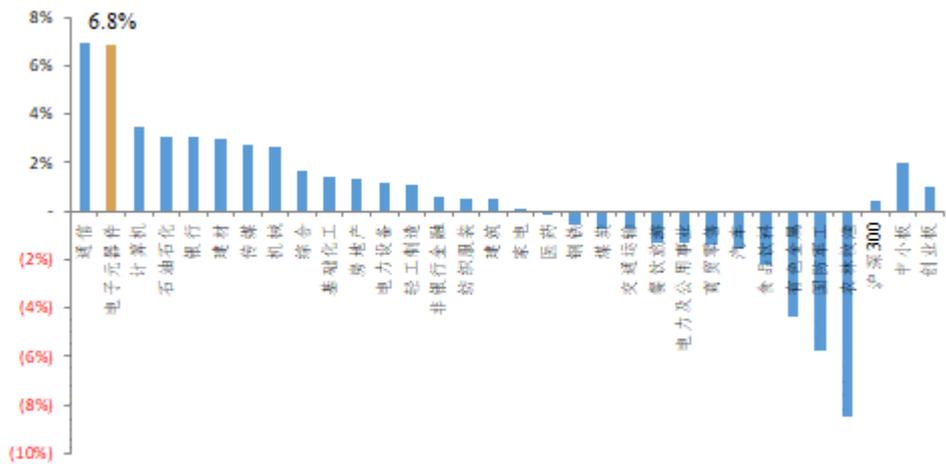
### 三、市场走势分析

上月电子元器件行业一级指数上涨 6.8%，跑赢沪深 300 指数 6.4 个百分点，在 29 个一级指数中位列第 2 位，排名领先。海外市场方面，香港资讯科技指数、美国费城半导体指数和台湾资讯科技指数走势均强于市场整体。上月香港恒生资讯科技指数上涨 3.2%，跑赢恒生指数 1.8 个百分点；费城半导体指数上涨 3.6%，跑赢标普 500 指数 1.9 个百分点；台湾资讯科技指数上涨 3.8%，跑赢加权指数 1.8 个百分点。

#### (一) 国内 A 股市场走势分析

上月电子元器件行业一级指数上涨 6.8%，在 29 个一级指数中位列第 2 位，排名领先。

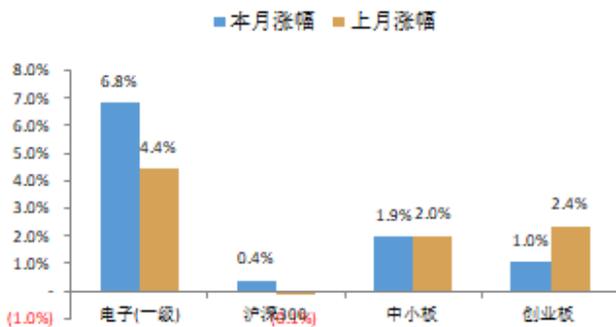
图 28：中信行业一级指数涨跌幅



资料来源：Wind，华金证券研究所

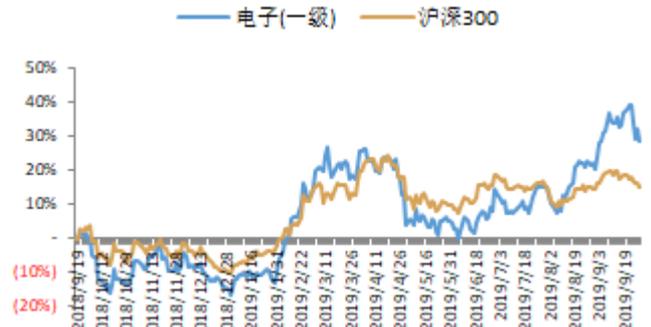
上月电子元器件行业一级指数上涨 6.8%，分别跑赢沪深 300 指数、中小板指数和创业板指数 6.4、4.9 和 5.8 个百分点。

图 29：电子一级指数 v.s.市场整体指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

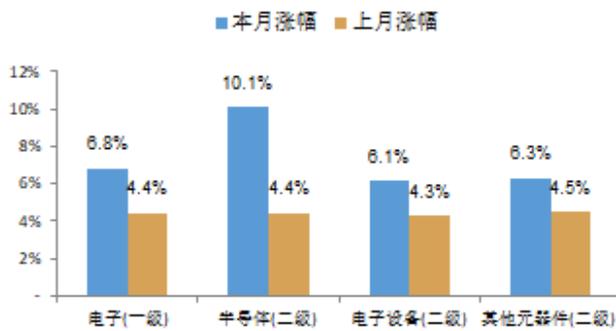
图 30：电子一级指数 v.s.沪深 300 指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

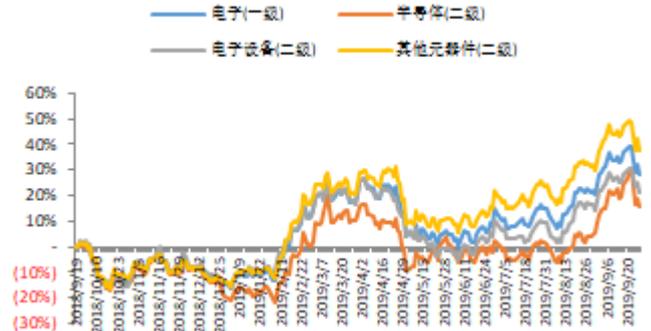
过往 250 个交易日累计涨幅，电子元器件行业一级指数为上涨 28.3%，走势强于沪深 300 指数 15.2% 的涨幅，整体走势反弹且强于市场。电子行业二级指数方面，子行业整体上涨，半导体、电子设备和电子元件行业分别上涨 10.1%、6.1% 和 6.3%。

图 31: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 32: 电子二级指数 v.s. 电子一级指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

从行业个股涨幅情况看, 本月行业个股上涨情况较多, 涨幅前三位分别为睿能科技(603933)、激智科技(300566)和三利谱(002876), 涨幅榜后三位分别为银河磁体(300127)、亿纬锂能(300014)和精研科技(300709)。

表 2: 电子元器件行业个股涨跌幅榜

代码	公司名称	涨幅	所属二级行业	代码	公司名称	涨幅	所属二级行业
涨幅前十				跌幅前十			
603933	睿能科技	57.2%	电子设备 II	002289	*ST 宇顺	(10.9%)	其他元器件 II
300566	激智科技	45.9%	电子设备 II	300545	联得装备	(11.4%)	电子设备 II
002876	三利谱	34.8%	其他元器件 II	300516	久之洋	(11.5%)	电子设备 II
002241	歌尔股份	33.6%	其他元器件 II	300462	华铭智能	(11.5%)	电子设备 II
002456	欧菲光	32.2%	电子设备 II	002402	和而泰	(11.9%)	其他元器件 II
600703	三安光电	30.1%	半导体 II	300139	晓程科技	(12.1%)	电子设备 II
000670	*ST 盈方	28.8%	半导体 II	300224	正海磁材	(14.6%)	其他元器件 II
002036	联创电子	28.4%	其他元器件 II	300709	精研科技	(14.9%)	其他元器件 II
002351	漫步者	25.5%	电子设备 II	300014	亿纬锂能	(15.6%)	其他元器件 II
000413	东旭光电	24.8%	其他元器件 II	300127	银河磁体	(22.2%)	其他元器件 II

资料来源: Wind, 华金证券研究所

从涨跌幅榜分布看, 二级行业中电子设备行业涨幅较大, 而其他元器件行业跌幅较大。

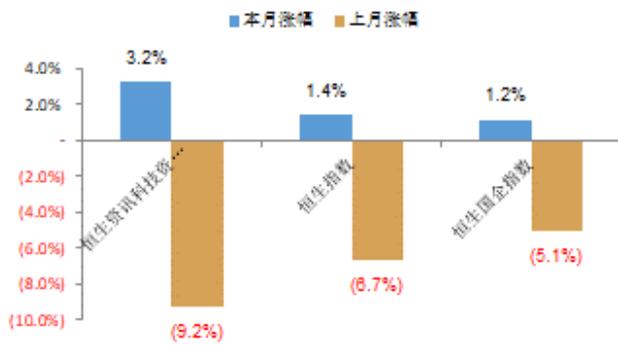
## (二) 海外市场走势分析

海外市场方面, 香港资讯科技指数、美国费城半导体指数和台湾资讯科技指数走势均强于市场整体。上月香港恒生资讯科技指数上涨 3.2%, 跑赢恒生指数 1.8 个百分点; 费城半导体指数上涨 3.6%, 跑赢标普 500 指数 1.9 个百分点; 台湾资讯科技指数上涨 3.8%, 跑赢加权指数 1.8 个百分点。

### 1、香港

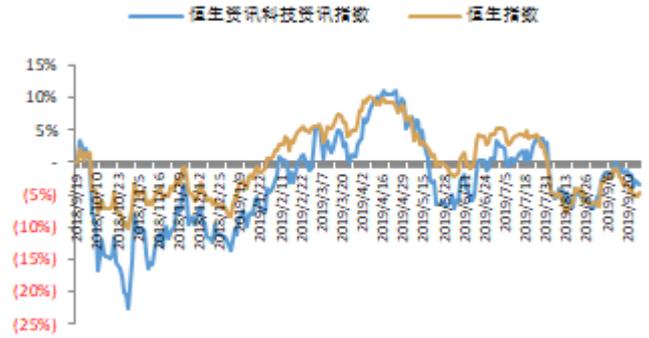
上月香港恒生资讯科技指数上涨 3.2%, 分别跑赢恒生指数和恒生国企指数 1.8 和 2.0 个百分点, 行业走势强于市场整体。

图 33: 恒生资讯科技指数 v.s. 市场指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 34: 恒生资讯科技指数 v.s. 恒生指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

过往 250 个交易日的累计涨幅看, 恒生资讯科技指数为下跌 3.4%, 跌幅低于恒生指数的 4.8%, 港股科技板块走势稍强于市场。

表 3: 香港资讯科技行业个股涨跌幅榜

代码	公司名称	涨幅	代码	公司名称	涨幅
涨幅前五			跌幅前五		
2280	慧聪集团	39.5%	0799	IGG	(7.9%)
1089	乐游科技控股	27.1%	0777	网龙	(8.5%)
0285	比亚迪电子	24.5%	1357	美图公司	(9.1%)
2018	瑞声科技	23.7%	1806	汇付天下	(11.6%)
1980	天鸽互动	19.8%	1282	宝新金融	(13.4%)

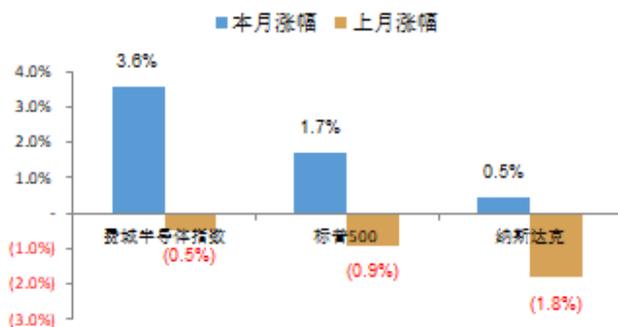
资料来源: Wind, 华金证券研究所

从行业指数成分股涨幅情况看, 上月涨幅前三位分别为慧聪集团 (2280)、乐游科技控股 (1089) 和比亚迪电子 (0238)。跌幅榜前三位分别为宝新金融 (1282)、汇付天下 (1806) 和美图公司 (1357)。

## 2、北美

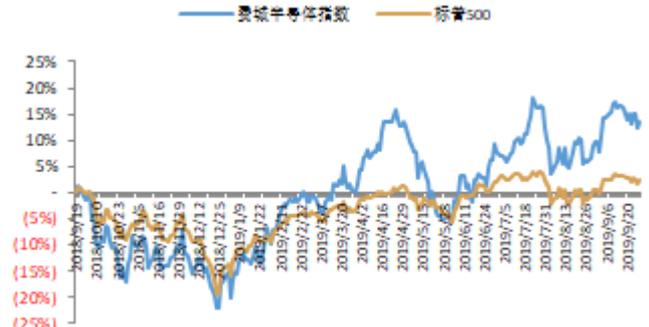
上月费城半导体指数上涨 3.6%, 分别跑赢标普 500 指数和纳斯达克指数 1.9 个百分点和 3.1 个百分点, 行业市场指数走势强于市场整体。

图 35: 费城半导体指数 v.s. 市场指数



资料来源: Wind, 华金证券研究所

图 36: 费城半导体指数 v.s. 标普 500 指数



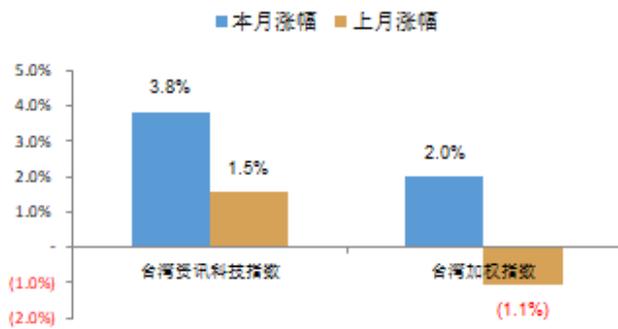
资料来源: Wind, 华金证券研究所

过往 250 个交易日累计涨幅，费城半导体指数累计上涨 13.6%，高于标普 500 指数 2.4% 的涨幅，行业走势显著强于市场。

### 3、台湾

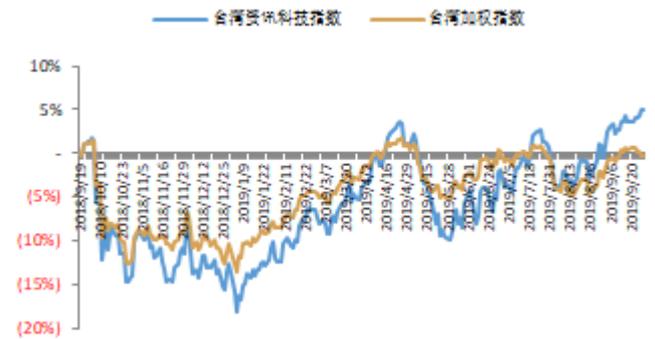
上月台湾资讯科技指数上涨 3.8%，跑赢加权指数 1.8 个百分点，行业指数强于大市。

图 37：台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

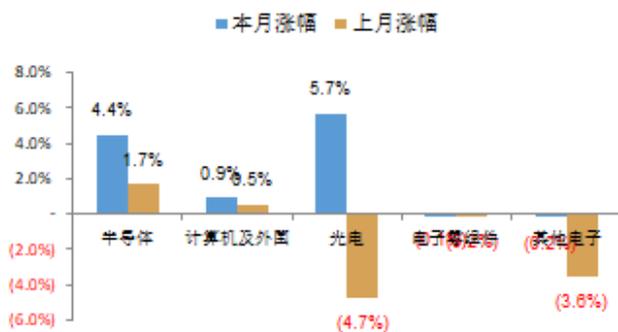
图 38：台湾资讯科技指数 v.s. 台湾加权指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

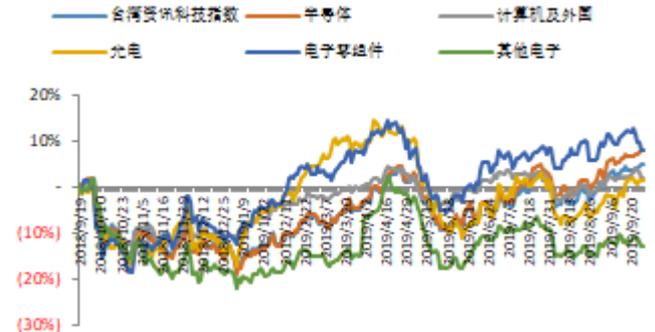
过往 250 个交易日累计涨幅，资讯科技指数上涨 4.9%，强于台湾加权指数 0.3% 的跌幅。

图 39：台湾资讯行业子版块指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

图 40：台湾资讯行业子版块指数 v.s. 资讯行业指数



资料来源：Wind，华金证券研究所

从子行业指数方面看，半导体、计算机及外围和光电行业分别上涨 4.4%、0.9% 和 5.7%，电子零组件和其他电子行业则分别下跌 0.1% 和 0.2%。

## 四、投资建议及个股动态

9月国内A股市场电子元器件行业涨幅较大,跑赢沪深300指数、中小板指数和创业板指数,细分二级行业来看,各子行业均不同程度上涨。9月是产业传统旺季,各大厂商密集发布智能终端产品,市场情绪持续高涨,主题投资的热情驱动估值上升使得行业走势强于市场。

未来,短期来看10月份是三季报披露的时间窗口,各大终端厂商本年度主要新品已基本亮相,对于产品的预期悉数落地,三季度旺季下市场情绪持续高位推动的估值大涨后需要行业基本面的有效支持,因此三季报显得尤为重要。半导体市场方面,国产化替代将在今年下半年凸显出影响,设计厂商忙于研发,代工厂和封测厂会是实质性受益方。因此,无论是消费电子还是半导体市场,10月成为验证市场行情与行业基本面是否匹配的关键时期,策略方面我们仍然延续9月“积极观望、谨慎参与”的建议,短期内看到的智能终端供应链上行空间有限,建议关注估值仍然可靠的个股,维持行业评级“同步大市-A”的整体评级。

个股投资推荐方面,三季报披露时间临近,行业近期涨幅较大使得个股估值水平显著上升,业绩方面的支撑将成为关键。因此我们需要保持谨慎,回避估值较高和业绩明显不达预期的标的,选择行业市场向好预期较强,并且估值水平横向纵向对比风险较低的个股。我们首选消费电子产业链和基础元器件的产业链,近期的安防行业产业热度也较为理想,产业链中与终端越接近的越有望优先受益。标的选择为立讯精密(002475)、长盈精密(300115)、莱宝高科(002106)、海康威视(002415)和江海股份(002484)。

表 4: 电子元器件行业个股投资建议列表

代码	名称	市值(亿元)	PE(2018)	PE(2019E)	PE(2020E)	PB
002475.SZ	立讯精密	1,431	53	41	30	8.64
300115.SZ	长盈精密	129	335	28	22	2.98
002106.SZ	莱宝高科	58	26	22	20	1.51
002415.SZ	海康威视	3,018	27	22	18	8.27
002484.SZ	江海股份	54	25	20	18	1.65

资料来源: Wind, 华金证券研究所(截止2019年9月30日收盘)

另外,我们建议持续关注标的不变,包括科森科技(603626)、三环集团(300408)、深天马A(000050)、三利谱(002876)、联创电子(002036)、欧菲光(002456)、环旭电子(601231)、全志科技(300458)、东软载波(300183)、汇顶科技(603160)、通富微电(002156)、太极实业(600667)、富瀚微(300613)、法拉电子(600563)等。

## 1、立讯精密（002475）

### 近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 78.3% 为 214.4 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 81.8% 为 15.0 亿元人民币，基本 eps 同比上升 79.6% 为 0.36 元。

公司发布 2018 年年报，全年销售收入同比上升 57.1% 为 358.5 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 61.1% 为 27.2 亿元人民币，基本 eps 同比上升 61.0% 为 0.66 元。

### 核心投资观点:

1) **传统业务规模增加:** 在无线充电、智能可穿戴设备的产业快速发展和应用渗透的过程中，公司作为核心供应商有望充分受益于产业链市场规模增加的预期，

2) **新兴业务拓展顺利:** 1) 公司通过自身的研发和供应链合作开拓进入了 5G 核心设备厂商的供应链体系，为公司未来的发展打下坚实基础；2) 汽车电子在智能化需求的推进下，也有望为公司的产品升级和产业定位升级提供机遇。

风险提示：核心客户的消费电子终端产品出货量不及预期；通讯市场的核心客户拓展不及预期；产品创新和生产经营落地速度不及预期，影响公司盈利能力。

## 2、长盈精密（300115）

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 9.3% 为 39.6 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 31.2% 为 1.2 亿元人民币，基本 eps 同比上升 32.1% 为 0.13 元。

公司发布 2018 年年报，全年销售收入同比上升 2.30% 为 86.3 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 93.3% 为 3,847 万元人民币，基本 eps 同比下降 93.3% 为 0.0423 元

### 核心投资观点:

1) **金属外观件进入海外一线厂商智能终端供应链:** 公司在智能手机和笔记本电脑分别进入全球一线的三星、苹果供应链体系，逐步实现从国内厂商到海外厂商在产品和订单规模上的有效转移，一方面有利于公司提升品牌形象，另一方面也能够提升公司的风险控制能力。

2) **智能制造业务成长可观:** 公司通过与安川合作成立基于机器人的智能制造子版块，通过对于制造业中自动化改造的机会，获得可靠的订单需求和业务落地，未来在制造业改造升级的过程中对于公司业务成长将会带来有效的新的成长机会。

3) **新能源汽车市场拓展持续:** 1) 公司新能源汽车电池结构件进入国内一线电池厂商，未来产能和订单成长空间广阔；2) 连接器结构件产品进入全球一线新能源汽车厂商供应链，随着终端扩张后公司的订单也有望快速提升。

风险提示：智能手机等产品市场出货量不及预期；精密结构件的市场竞争加剧影响公司盈利能力；公司机器人、新能源汽车等业务规模拓展不及预期。

### 3、莱宝高科（002106）

#### 近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 12.1%为 21.9 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 72.6%为 0.95 亿元人民币，基本 eps 同比上升 72.6%为 0.14 元。

公司发布 2018 年年报，全年销售收入同比上升 10.7%为 44.2 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 59.7%为 2.2 亿元人民币，基本 eps 同比上升 60.7%为 0.32 元。

#### 核心投资观点:

1) **中大尺寸触控显示稳定供货笔记本电脑核心厂商:** 公司在中大尺寸笔记本电脑的触控显示屏中已经与全球核心供应商均建立了良好的合作关系，并且已经实现稳定供货，而且公司重庆生产基地也在产能规模和良率保障方面有了较为显著的效率，因此能够给予公司稳定的业绩贡献。

2) **智能终端厂商入局高端笔记本电脑带来新的需求预期:** 包括华为、小米等传统的智能手机终端厂商开始进入到笔记本电脑市场，并且均推出相关高端触控类产品，公司在相关客户中均以获得较好的认可和可靠的订单，未来可能为公司提供新的需求订单来源。

3) **玻璃镀膜技术的衍生空间较为理想:** 公司核心技术为玻璃等基本材料方面的镀膜能力，未来在电子标签、变色玻璃、柔性镀膜等领域有着良好的技术储备和应用前景，产品不仅在智能终端厂商，还在零售、交通、工业等领域有着较为理想的应用空间。

风险提示：中大尺寸市场需求不及预期；产品良率不及预期或者产能扩张速度不及预期；汇率波动影响。

### 4、海康威视（002415）

#### 近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年半年报，上半年销售收入同比上升 14.6%为 239.2 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 1.67%为 42.2 亿元人民币，基本 eps 同比下降 1.11%为 0.444 元。

公司发布 2018 年年报，全年销售收入同比上升 18.9%为 498.1 亿元人民币，归属上市公司股东净利润同比上升 20.5%为 113.5 亿元人民币，基本 eps 同比上升 20.4%为 1.24 元。

#### 核心投资观点:

1) **国内市场层面:** 国内安防市场主要由政府投资驱动，我们预计一方面作为基础设施相关的安防视频监控需求在地方政府财政支出有望增加的情况下，将会获得有效的订单推动，另一方面包括国有企业在内的大型企业在增加高水平的 AI 功能的监控下，能够有效替代人力实现安全生产等需求，因此驱动力也来源于市场层面。

**2) 海外市场层面:** 尽管收到了来自美国、加拿大、澳大利亚等海外政府对于信息安全的质疑,但是由于安防监控的充分本地化以及公司的积极努力下,我们公司在海外民用市场继续维持现有稳健拓展的局面。

**3) 泛安防市场的发展:** 在传统安防视频监控在公安、交通、金融、司法、工业等领域的应用持续推进的过程中,我们可以看到在文教、家庭、社区、娱乐等市场中,视频监控的渗透也在持续提升,泛安防市场的发展给予行业新的成长动力。

风险提示:国内政府及大客户的订单投入和实施进度不及预期;中美贸易战以及国际贸易争端发展超预期;创新业务发展不及预期以及产品竞争带来盈利能力下降。

## 5、江海股份 (002484)

### 近期动态及最新财务数据:

公司发布 2019 年半年报,上半年销售收入同比上升 5.8%为 9.6 亿元人民币,归属上市公司股东净利润同比下降 5.1%为 1.0 亿元人民币,基本 eps 同比下降 5.1%为 0.13 元。

公司发布 2018 年年报,全年销售收入同比上升 17.6%为 19.6 亿元,归属上市公司股东净利润同比上升 28.2%为 2.43 亿元,基本 eps 同比上升 28.2%为 0.2988 元。

### 核心投资观点:

**1) 上游产能逐步释放解决公司订单执行:** 公司 2018 年在上游受到环保限产的影响下仍然能够实现收入和利润的有效成长,预计在 2019 年随着铝箔产能逐步释放,化成箔和腐蚀箔的供给也不再成为公司的瓶颈,因此随着新老客户订单规模的推进,公司将会继续维持稳健的成长特性。

**2) 自身产能建设推进:** 公司在湖北罗田新建的产能有望在 2019 年逐步释放,对于公司现有南通产能不仅是有效的补充,更为重要的是新建产能在设施、资源、人力方面的高效提升也将会为公司的盈利能力提升带来正面作用。

**3) 产品技术能力推进:** 公司在传统铝电解电容方面有着良好的竞争力,同时也在积极推动薄膜电容器、超级电容器的技术水平和产品市场认可,随着过去几年的努力,公司有望逐步实现产品市场的有效扩张。

风险提示:电容器价格下降幅度超预期;上游原材料市场供给出现不稳定情况;薄膜电容器和超级电容器市场拓展速度不及预期。

## 五、风险提示

相关个股业绩不达预期；

需求旺季逐步来临的过程中实际需求增速不及预期；

终端产品中在无线通信、传感器、人机交互等功能方面的创新无法达到消费者认可；

贸易争端带来的终端需求变化以及产业链影响的不确定性；

国产化自主可控的产业政策推出与落地实施不及预期风险。

## 行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

## 分析师声明

蔡景彦声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

### 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

### 免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

### 风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区锦康路 258 号（陆家嘴世纪金融广场）13 层

电话：021-20655588

网址：[www.huajinsec.com](http://www.huajinsec.com)